

# 月度市场报告

安森美、ADI、德州仪器、松下等多家原厂发布2026年  
涨价函

2025年12月刊

新汉科技

仅供内部使用

# 目录

本月重点 .....	3
原厂动态 .....	4
行业趋势 .....	9
高风险物料预警 .....	13

# 本月重点

1. 安森美将于 2026Q1 调涨产品价格
2. ADI 宣布 2026 年 2 月起涨价 15%
3. 德州仪器部分通用型物料涨价或持续至 2026 年 2 月
4. Lattice 2026 年 3 月起全线涨价
5. 松下半导体宣布 2026 年 2 月起涨价
6. Macronix 宣布 2026 年 1 月起涨价

---

本报告每月发布一次，部分消息源自于我们供应商或客户的所见及所闻，部分消息来自于渠道直接或间接提供。本报告由新汉科技整理并做简单分析，并不代表新汉科技观点及立场，仅供参考与学习。网络消息繁杂，请大家注意甄别。

# 原厂动态

## 本月存储市场价格依旧高涨

本月 DRAM 和 NAND 仍保持强势的上涨趋势。由于 DDR4 价格大幅上涨，三星已放缓 DDAR 的停产进程，并与特定客户签订长期合同，绑死供货条件，不得取消或更改，确保在产能调度上实现利润最大化。基于 AI 需求的长期增长和产能调整的周期性，业内普遍认为涨价潮将持续到 2026 年年中。预计元旦后镁光 LPDDR4/5x 的涨幅在 30%-35%，DDR4/5 涨幅在 40%左右。

## 三星 UPCP、EMCP 暂停报价

三星的 UMCP、EMCP 的产能很少，原厂暂停报价，只能开价抢货。三星的 EMMC4-32G 最后的出货时间为 2026 年 3 月，导致目前市场上有大量贸易商在囤货。代理预计存储的市场行情和持续到 2026 年 Q2，且预计三星近两个月还会持续涨价。

## 镁光 LPDDR4 供货压力增加，市场价格持续拉高

由于三星 LPDDR4 即将停产，而这部分客户订单将转移到镁光，导致镁光的供货压力增大。而从 2026 年 1 月 1 日起，代理商下个原厂的订单都不允许取消、变更或更改等操作，预计元旦后会持续拉高市场价格。

## Macronix 宣布 2026 年 1 月起涨价

Macronix 近日正式通知 2026 年 Q1 将涨价，涨幅在 30-50%。面对晶圆涨价、订单产能爆满等情况，Macronix 今年累计涨幅已超过 100%。以往 Marconix 只专注于 NOR Flash，因三星的 EMMC 停产，Marconix 今年推出了 EMMC 产品，年中才开始量产，但目前已得到客户的认可并得以广泛应用。而 Marconix 的价格策略是宁愿产能过剩也不降价，故其毛利相对较高。目前 Marconix 的需求主要集中在 512Mb，也有 1GB 至 2GB 的需求。

## 德州仪器部分通用型物料涨价或持续至 2026 年 2 月

德州仪器逻辑、LM 系列等通用物料从 12 月开始涨价，预计会持续到 2026 年 2 月，主要是因为新旧晶圆更迭，原厂为推动客户接受新物料，针对老物料进行不同程度的涨价，到期的价格也不会给折扣，导致目前整体交期被拉长。此外，德州仪器在 AI 服务器领域的需求仍然较多，除部分物料供应紧俏有涨价趋势外，其他的还在观望中。

## ADI 宣布 2026 年 2 月起涨价 15%

ADI 2025 年全年营收预计 94.27 亿美元。工业领域全年占比 47%，第四季度营收 11.92 亿美元，工业自动化和能源管理需求支撑增长。汽车电子全年占比 30%，第四季度营收 7.49 亿美元，电动汽车动力系统和传感器布局持续渗透。消费电子全年占比 13%，第四季度营收 3.23 亿美元，智能手机、可穿戴设备及智能家居需求回暖。通信领域全年占比 12%，第四季度营收 2.90 亿美元，5G 基站建设和卫星通信贡献增量。

与此同时，官方宣布 2026 年 2 月起全线产品涨价约 15%，军规级产品涨幅高达 30%，涨价原因一方面是原材料的上涨，二是原厂要提高毛利率。

## 意法半导体加大研发与制造的资金投入

意法半导体和欧洲投资银行签署总额 10 亿欧元的信贷额度协议，资金将专项支持意法半导体在意大利和法国的半导体研发与大规模制造项目。其中 60% 资金用于提升卡塔尼亚、阿格拉特等核心生产基地的制造能力，40% 投入技术研发，整体契合欧盟绿色转型与技术主权战略目标。协议核心资助对象之一是意法半导体卡塔尼亚工厂，该基地是规划中的碳化硅全产业链晶圆厂，集 8 英寸碳化硅功率器件制造、封装、测试于一体。此次 10 亿欧元信贷将进一步补充建设与产能爬坡资金，其全面落成后碳化硅晶圆年产能可达 72 万片（折合 1.5 万片/周），将大幅提升全球碳化硅供给能力。正式投产后，碳化硅的交期会逐渐缩短，目前交期在 20 周左右。

## 英飞凌扩产 12 英寸产线

英飞凌在德国德累斯顿的 12 英寸产线扩产，产能逐步释放。目前大部分汽车功率器件交期稳定在 16-20 周。

奥地利、马来西亚的封测厂扩产，工业级产能释放，工业 MCU 交期小幅缩短至 12-12 周。

### **安森美将于 2026Q1 调涨产品价格**

安森美 2026 年 Q1 开始整体产品线价格将上调，涨幅 5-10%。目前安森美车规级产品交期普遍延长至 12-20 周；电源管理 IC 和专用传感器交期延长至 16-26 周。通用型低压 MOS、二三极管供应大幅缓解，部分型号已回归正常库存水位，价格区趋于稳定。热销产品集中在 SiC 功率器件和电源管理 IC，如 EliteSiC 系列、NCV 系列和 NSV 系列，交期在 30-40 周。

### **英特尔小核 CPU 供应紧张**

英特尔小核 CPU 交期依旧较长，原厂产能优先给大核 CPU，小核 CPU 又优先供应给大客户，中小型客户基本拿不到货。部分客户与原厂沟通加急时，会被原厂要求一比一配货，即小核 CPU 带 14 代 CPU。

### **博通 BCM 系列产品单价高且交期长**

博通近期热门型号主要集中在 SX 系列、BCM56962 系列和 BCM88 系列，目前报价以高于正常水平，部分价格翻番。BCM 系列产品占博通主要销售业绩，该系列型号较偏，如 BCM56880B0KFSBG、BCM88823CA1IFSB，分别应用在数据中心和网络交换，交期普遍在 52 周以上，该系列大多由原厂与客户直接配合，单价高且周期长。

### **赛灵思交期普遍延长**

代理商反馈赛灵思交期普遍拉长，交期基本延期到 2026 年 Q2、Q3，主要原因是原材料和封测基板的短缺，加之赛灵思目前优先生产 GPU。

## **Altera EP4S 和 5CG 系列供应紧张**

Altera 的 EP4S、5CG 系列缺货，交期拉长到 24-28 周。这两个系列都是千兆/万兆级高端运算系列，主要应用在 AI 领域。此外 Altera 目前高端、工业级车规级的物料供应紧张。

## **Lattice 2026 年 3 月起全线涨价**

Lattice 2026 年 3 月起全系列涨价，涨幅 5% 左右，不同系列涨幅不一样，部分型号上调幅度较高，如 LC4256V-75TN176C 原厂官价上调 40%。

## **Skyworks 部分物料价格暴涨**

Skyworks 的 Wi-Fi 6/6E 和 5G 射频前端芯片成为市场焦点，价格账上 10-15%，且交期普遍超 20 周。二极管和通用射频元件因产能调整出现短期缺货和大幅涨价，如 SKY85772-11 SKY65111-348LF、SKY65111-348LF、SMP 系列二极管等。

## **松下半导体宣布 2026 年 2 月起涨价**

松下半导体正式给代理商分销商发出涨价通知函，自 2026 年 2 月 1 日起，针对聚合物钽电容进行价格调整，涨价主要原因为原材料成本、能源成本和人工成本的上升。目前原厂的涨价函没有给出具体的涨价幅度，但据传涨幅在 15-20%，且目前大部分代理商已暂停对钽电容的报价订货，都在等松下的具体价格通知。

## **欧姆龙部分车规类产品已实现量产**

欧姆龙针对新能源汽车研发的高压配电箱（PDU）、车载充电机（OBC）、电子断开单元（BDU）等关键部件已实现量产。其 G8PC 车载 AC 功率继电器可应对高负载工况，适用于电动汽车及移动充电桩，高精度 MEMS 传感器（如 2SMPB-02B 系列）被集成于欧姆龙工业机器人关节，用于实时监测振动、温度等参数，实现设备健康状态预测，预计 2025 年工业自动化领域半导体业务营收增长 12%。另外在东南亚，欧姆龙



的汽车电子传感器已进入丰田、本田的 EV 供应链，2025 年该地区半导体业务营收增长 28%。在印度，其与塔塔集团合作的智能电表项目采用欧姆龙压力传感器，预计 2026 年出货量达 500 万只。

## 京瓷收购 NEC 33%的股份合作下一代光互联技术

京瓷于 2025 年 10 月 30 日宣布，从 NEC 手中收购 JAE 约 33%的股份，京瓷希望结合其电子元器件与 JAE 的连接技术，为客户提供更完整的解决方案。京瓷将利用其海外工厂为 JAE 生产连接器，帮助 JAE 拓展其薄弱的欧美市场。双方计划在汽车、数据中心等领域合作开发小型、高耐压连接器及下一代光互连技术。

## HRS 产品涨价持续中

HRS 目前的业绩增长点还是在 AI、新能源汽车和工业自动化三大领域。HR10A+系列工业级圆形连接器，支持 10Gbps 传输，用于 AI 机器人和智能制造设备，市场需求量逐步增加。汽车高压 800v 连接器在中国市场占比 80%，由于近年来金属价格持续上涨，HRS 在 25 年第三季度以来已经上涨了部分系列产品的价格，涨价幅度比较大的系列型号比如 ER8-20S-0.8SV-7H 从之前的 0.8u 涨到了 1.4usd 左右，HRS 的这一涨价策略针对全球市场，只保留了日本本土一些大客户的价格，其他客户只能被迫接受涨价。



# 行业趋势

TrendForce 表示，加速汽车电气化和智能化将推动汽车半导体市场到 2029 年达到近 1000 亿美元

TrendForce 的最新调查显示，汽车电气化和智能化的快速发展预计将推动全球汽车半导体市场从 2024 年的约 677 亿美元增长到 2029 年的近 969 亿美元，在 2024 年至 2029 年期间的复合年增长率为 7.4%。然而，汽车半导体各细分领域的增长极不均衡。以逻辑处理器和先进存储器为代表的高性能计算芯片，其增长速度远超微控制器等传统组件。这种差异反映出市场价值正迅速向实现车辆智能化和电气化的核心技术转移。

TrendForce 的研究表明，到 2025 年，包括纯电动汽车 (BEV)、插电式混合动力汽车 (PHEV)、燃料电池汽车 (FCV) 和混合动力汽车 (HEV) 在内的全球电动汽车渗透率预计将达到新车销量的 29.5%。与此同时，汽车制造商正在加快推进车辆智能化，这依赖于多传感器配置、高速连接和人工智能模型部署。

电子电气架构也正经历着类似的转变，从分布式架构向以领域为中心、完全集中式的系统发展。传感器数据的快速增长和人工智能模型日益复杂，正推动着汽车计算能力需求的显著提升。

汽车制造商正在探索车身控制、远程信息处理、智能驾驶和智能座舱等领域不同层次的功能集成，而半导体供应商在这些领域至关重要。随着芯片制造商开发集成座舱-ADAS SoC，这种融合架构的商业化进程将于 2025 年开始。

控制器整合减少了 ECU 的数量，实现了组件共享，简化了线束，并带来了成本优势，有望进一步加速车辆智能化的发展。TrendForce 预测，2024 年至 2029 年，汽车逻辑处理器的复合年增长率将达到 8.6%，高于 7.4% 的整体市场平均水平。

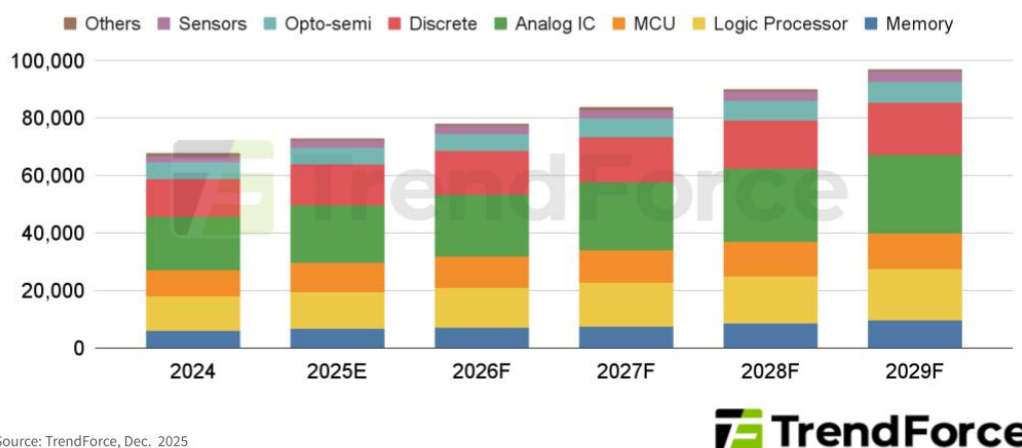
随着新进入者挑战现有企业，竞争加剧。

由于半导体各细分市场的增长率存在差异，芯片制造商之间的竞争日益激烈。服务器市场的领军企业英伟达和移动芯片组领域的领导者高通，正利用高性能处理器和强大的软硬件生态系统，积极拓展汽车智能领域。得益于技术进步、本土化政策以及对智能汽车解决方案的强劲需求，像地平线机器人这样的中国企业也在迅速崛起。尽管传统汽车半导体供应商面临越来越大的压力，但它们丰富的产品组合、久经考验的可靠性以及深厚的客户关系仍然是关键的竞争优势。

TrendForce 指出，汽车半导体市场格局高度多元化，每家供应商都面临着独特的机遇和挑战。在这个不断

变化的市场中，成功与否取决于能否在整个生态系统中建立战略联盟，并提升软硬件集成能力。仅仅依靠硬件性能已不足以确保长期的竞争力。

**2024–2029 Forecast of Global Automotive Semiconductor Market Size** (Unit: Million USD)



## 各国人工智能竞争力排名

### 什么是 AI 活力工具？

斯坦福大学的全球人工智能活力工具是一个综合性的仪表盘，旨在衡量和比较一个国家人工智能生态系统的“活力”。该工具并非侧重于单一指标，而是使用涵盖研究、经济竞争力、基础设施、政策与治理以及公众舆论等八大支柱的 42 项指标。

这一综合评分有助于展现创新和人才的集中区域，以及正在出现的差距。该方法有意采用多维度视角，将研发产出等传统指标与政策参与和负责任的人工智能应用相结合。

### 为什么美国和中国领先

美国凭借其在私人投资、学术研究和人工智能初创企业领域的领先地位，位居榜首。其本土科技巨头和卓有成效的研究机构推动了全球人工智能创新发展的重要份额。

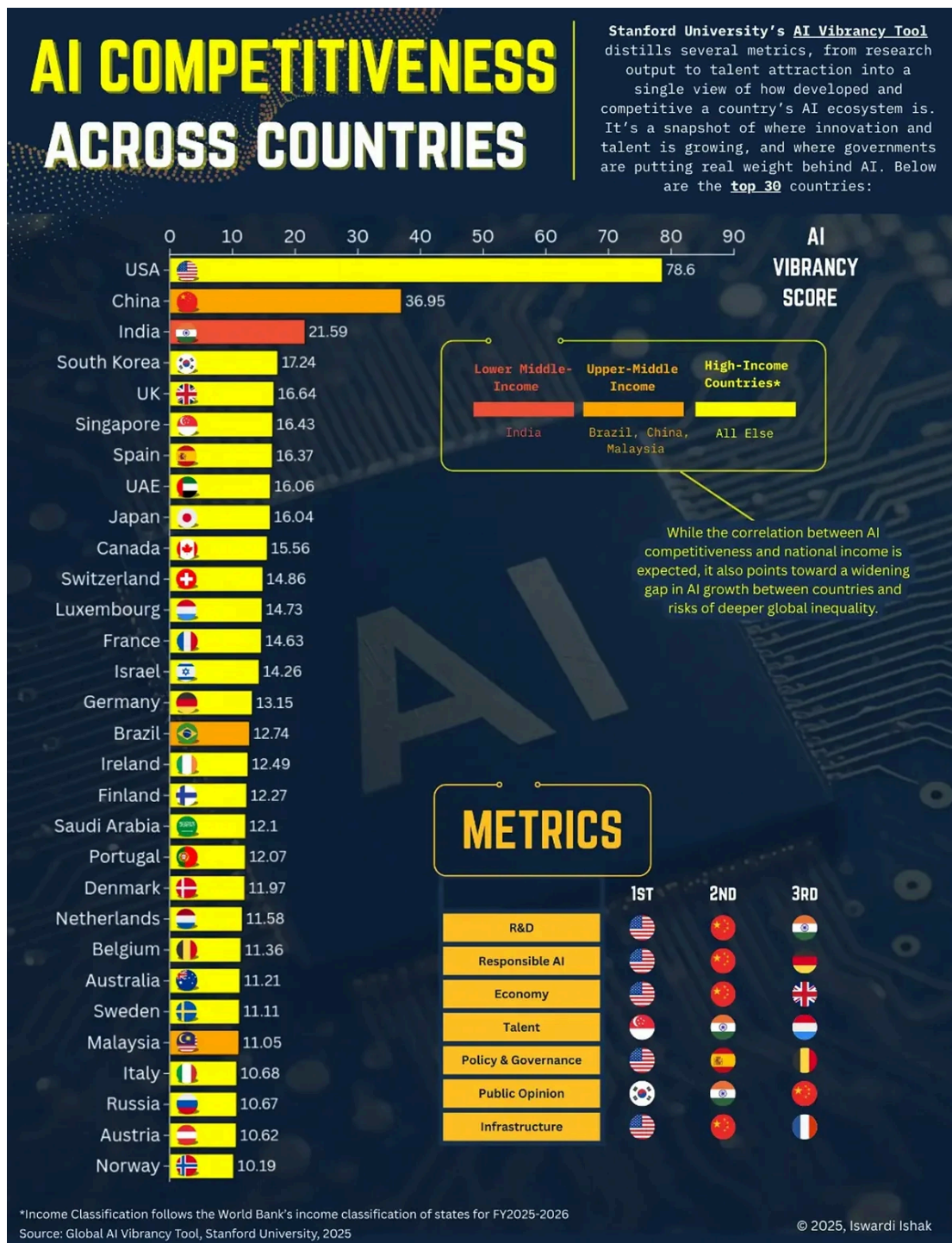
中国紧随其后，这得益于人工智能出版物、专利申请的快速增长以及人工智能技术在各行业的大规模部署。尽管在某些领域落后于美国，但中国在模型开发和研究产出方面正不断缩小差距。

印度的排名反映了其不断壮大的人工智能人才库和强大的数字生态系统，尽管它在扩大研究基础设施规模以达到全球领先水平方面仍面临挑战。外部分析也同样表明，印度人工智能研究人员和政策制定者的参与度

正在不断提高。

#### **新兴和区域参与者**

除了前三名之外，许多规模较小但经济发达的国家也表现出色。像新加坡和英国这样的国家受益于有利的政策框架、强大的人力资本和蓬勃发展的科技产业。这些因素帮助它们在全球竞争日益激烈的环境中脱颖而出。



## 高风险物料预警

Part Number	Manufacturer
XC3S1000-4FGG676I	XILINX INC
NCN8026AMNTXG	ON SEMICONDUCTOR
EPM7064SLI44-7N	ALTERA CORP
AD775JR	ANALOG DEVICES INC
TMS32C6414EGLZ5E0	TEXAS INSTRUMENTS INC
NCV70624DW010R2G	ON SEMICONDUCTOR
IXTH48N65X2	IXYS CORP
SRN6045-2R2Y	BOURNS INC

注：该部分数据来源于 ERAI，仅供参考。